

(0,80mm) .0315"

RU8, HSC8 系列



RU8-160-25-SE-L-DV-BL

HSC8-050-02-25-DP



加高型高速转接卡套件

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com?RU8

连接器:
绝缘体材料:

黑色液晶
聚合物

触点: 镀铜

电镀: 在 50μ" (1,27μm)

的镍上镀金或锡

额定电流:

30°C 温升时为 3.1A

(详情参见网站。)

工作温度:

-55°C 至 +125°C

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面性:

(0,10mm) .004" 最大 (40-60)

符合 RoHS 规范要求:

是



支持的
协议

PCI Express®
XAUI, SATA

登录 www.samtec.com/appnote

下载应用程序注释

与 SIG @ samtec.com 联系

了解有关协议的问题

RU8

1

每排位置数

40, 50, 60

堆叠高度

-19
= (19mm) .748"

-25
= (25mm) .984"

-30
= (30mm) 1.180"

信号路由

-SE
= 单端

-DP
= 差分对

电镀选项

-L
= 触点镀 10μ" (0,25μm) 的金, 焊尾镀雾锡 (连接器的电镀) 卡的电镀为硬质金。

DV

BL

-BL
= 板锁 (仅限底部插口) (-19 堆叠高度上不提供)

其他选项

对货盘, 保留空白

-K
= (5,50mm) .217" 直径的聚酰亚胺膜取放垫

-TR
= 卷带封装

注: 有些长度、式样和选项为非标准型, 不可退换。

套件包含两个连接器和一张卡。需要组件。

注: 提供其他镀金选项。请联系 Samtec。

每侧位置数	A	B	-SE 信号线路总数	-DP 信号对总数
40	(39,80) 1.567	(50,39) 1.984	40	26
50	(47,80) 1.882	(58,39) 2.299	50	32
60	(55,80) 2.197	(66,40) 2.614	60	38

0.80mm 间距 RU8		在 3dB 插入损耗的额定值	
25mm 堆叠高度			
单端信号		7.5 GHz/15 Gbps	
差分对信号		7.5 GHz/15 Gbps	

如需完整测试数据, 请浏览 www.samtec.com?RU8 或联系 sig@samtec.com

配件:
HSEC8

技术规格

若需要完整的技术规格, 请浏览 www.samtec.com?HSC8

导体:

1/2 oz 铜

触点区域:

镀硬质金

绝缘体: FR-4

符合 RoHS 规范要求:

是

每侧位置数	-SE 信号线路总数	-DP 信号对总数
-040	40	26
-050	50	32
-060	60	38

注: 某些尺寸、式样和选项为非标准型, 不可退换。

HSC8

每侧位置数

-040, -050, -060

卡式样

-02
= (1,60mm) .062" 厚度的卡

堆叠高度

-19
= (19mm) .748"

-25
= (25mm) .984"

-30
= (30mm) 1.180"

信号路由

-SE
= 单端

-DP
= 差分对

每侧位置数 x (0,80) .0315 + (4,45) .175

信号

接地

信号

接地

堆叠高度	A
-19	(14,84) .584
-25	(20,84) .820
-30	(25,84) 1.017